Technisches Datenblatt
Hartlot CuP 286

Norm:

DIN EN ISO 17672:	CuP 286
DIN EN 1044:	CP 101
DIN 8513:	-
EN ISO 3677:	B Cu75AgP 643

Zusammensetzung:

Cu (Gew.-%)	Ag (Gew.-%)	P (Gew.-%)	-
Rest	**18**	**7,05**	**-**

Zulässige Verunreinigungen max. (Gew.-%): Al 0,001;Bi 0,030 Cd 0,01 Pb 0,025;Zn 0,05+Cd 0,05
Gesamtverunreinigungen max. (Gew.- %): 0,25

Technische Angaben:

Schmelzbereich	Arbeitstemperatur	Dichte	Zugfestigkeit	Dehnung	Elek. Leitfähigkeit
ca. 645°C	ca. 650°C	ca.8,4 g/cm³	Cu=250MPa	-	-

Eigenschaften:

Gut fließendes, niedrigschmelzendes, phosphorhaltiges Hartlot für Betriebstemperaturen von -70°C bis max. 150°C (ohne Festigkeitsverlust).
Grundwerkstoffe: Kupfer- und Kupferlegeirungen (Kupfer an Kupferverbindungen können aufgrund des P- Gehaltes im Lot ohne Flussmittel durchgeführt werden).
Lötverfahren z.B.: Flammlöten, Induktionslöten, Schutzgasofen.
Anwendungsgebiete z.B.: Elektroindustrie, Kälte- und Klimatechnik.

Anmerkung:

Aufgrund einer Sprodphasenbildung nicht geeignet zum Verbinden von Stahl- und Nickellegierungen.
Nicht zulässig im Einsatz für schwefelhaltige Medien.

Standard Lieferformen:

Draht:	1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm
Stäbe:	1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm
Formteile:	Ringe, Biegeteile, Abschnitte

Anwendungstechnik:

Armin Hain GmbH & Co.KG
Herr Sascha Hain
Tel.: 0 61 84 – 9 32 87- 22
eMail: sascha.hain@armin-hain.de

Die Angaben in diesem Technischen Datenblatt geben den derzeitigen Kenntnisstand über unser Produkt wieder. Das Technische Datenblatt dient der Produktbeschreibung im Hinblick auf die Technischen Anforderungen. Die Angaben sind jedoch keine Zusicherungen von Eigenschaften unseres Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften und erfolgen unverbindlich.